

<<电子产品结构工艺>>

图书基本信息

书名：<<电子产品结构工艺>>

13位ISBN编号：9787121006678

10位ISBN编号：7121006677

出版时间：2005-7

出版时间：电子工业出版社

作者：龙立钦

页数：206

字数：348800

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<电子产品结构工艺>>

内容概要

本书内容包括：电子产品结构工艺基础，电子产品的防护，电子元器件及材料，焊接技术，印制电路板，电子产品装配工艺，表面组装工艺技术，电子产品调试工艺，电子产品技术文件，电子产品结构

。本书安排了相应的技能训练，章后附有小结和习题，书末有附录。

本书取材新颖，表述简练，通俗易懂。

充分体现职业教育的特点，适合于作为中等职业学校电子技术类教材使用，也可作为有关职业教育和工程技术人员的技术参考和自学用书。

本书还配有电子教学参考与资料包，详见前言。

<<电子产品结构工艺>>

书籍目录

第1章 电子产品结构工艺基础 1.1 概述 1.1.1 电子产品的特点 1.1.2 电子产品结构工艺概述 1.1.3 本课程的任务 1.2 对电子产品的基本要求 1.2.1 工作环境对电子产品的要求 1.2.2 电子产品的生产要求 1.2.3 电子产品的使用要求 1.3 电子产品的可靠性 1.3.1 可靠性概述 1.3.2 可靠性设计的基本原则 1.3.3 提高电子产品可靠性的途径 本章小结 习题1第2章 电子产品的防护 2.1 气候因素的防护 2.1.1 潮湿的防护 2.1.2 盐雾和霉菌的防护 2.1.3 金属的防护 2.2 电子产品的散热及防护 2.2.1 热的传导方式 2.2.2 提高散热能力的措施 2.2.3 晶体管及集成电路芯片的散热 2.3 机械因素的隔离 2.3.1 减震和缓冲的基本原理 2.3.2 减震和缓冲的一般措施 2.4 电磁干扰的屏蔽 2.4.1 电场的屏蔽 2.4.2 磁场的屏蔽 2.4.3 电磁场的屏蔽 2.4.4 屏蔽的结构形式与安装 本章小结 实训项目 典型电子产品解剖 习题2第3章 电子元器件及材料 3.1 电阻器 3.1.1 概述 3.1.2 电阻器基本类型 3.1.3 电阻器的选择和使用 3.2 电容器 3.2.1 概述 3.2.2 电容器的基本类型 3.2.3 电容器的选择和使用 3.3 电感器 3.3.1 概述 3.3.2 电感器的基本类型 3.3.3 电感器的选择和使用 3.4 半导体器件 3.4.1 概述 3.4.2 半导体二极管 3.4.3 半导体三极管 3.4.4 集成电路 3.5 表面组装元器件 3.5.1 概述 3.5.2 常见表面组装元器件 3.5.3 表面组装元器件发展趋势 3.6 电子材料 3.6.1 绝缘材料 3.6.2 导电材料 3.6.3 磁性材料 本章小结 实训项目 检测元器件练习 习题3第4章 焊接技术第5章 印制电路板第6章 电子产品装配工艺第7章 表面组装工艺技术第8章 电子产品调试工艺第9章 电子产品技术文件第10章 电子产品结构附录A 电子产品电阻器、电容器的型号命名及标志方法附录B 半导体器件的型号及命名参考文献

<<电子产品结构工艺>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>